

上海概伦电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的

半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将 2026 行动方案进展半年度评估情况报告如下：

一、专注公司经营，持续提升核心竞争力

概伦电子作为国内首家 EDA 上市公司，是关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业。2026 年上半年，公司实现营业收入 24,039.28 万元，较上年度同期增长 10.05%。实现主营业务收入 24,023.07 万元，较上年度同期增长 10.17%。从分产品收入情况看，EDA 软件授权业务实现收入 16,041.37 万元，同比增长 8.07%，占公司主营业务收入的 66.77%。半导体器件特性测试系统业务实现收入 3,045.96 万元，占公司主营业务收入的 12.68%；技术开发解决方案业务实现收入 4,935.74 万元，占公司主营业务收入的 20.55%。

1. 加快研发进度，提升产品多样性

（1）AI 赋能 DTCO

根据人工智能加速渗透至 DTCO（设计-技术协同优化）及设计流程优化环节的技术发展趋势，公司积极践行 AI 赋能 DTCO 的战略方向，主张通过工艺、器件、模型、PDK、电路仿真与良率分析、IP 的全链路协同，系统性地缩短研发迭代周期，提升 PPA（性能、功耗、面积）表现与良率水平，并借助神经网络模型与大数据处理技术，大幅缩短传统工艺与设计迭代周期，依托在 EDA 领域的既有优势，将能力边界向先进工艺节点及高端芯片设计的全流程价值延伸。报告期内，公司重点推进新一代 SPICE 模型自动化提取平台 MS-SDEP™的市场推广与客户导入，该平台集成完整的模型分析、参数提取与质量校验核心技术，依托灵活可视化 GUI 与丰富 API 能力实现建模流程的快速定制与复用，通过目标协同优化全面提升建模精度与效率；全新 AutoCell™标准单元版图自动化平台，集成高速布局布

线引擎，实现版图设计到验证全流程自动化，有效应对先进工艺持续微缩带来的标准单元版图设计周期拉长瓶颈，助力客户优化芯片 PPA 与良率。

(2) 全芯片电路仿真解决方案升级

报告期内，公司电路仿真解决方案完成从分散式单点工具向一体化全场景验证平台的战略性升级。公司以 NanoSpice™系列家族化为载体，在上述既有产品基础上叠加智能调度与协同仿真能力，实现三大核心变化：NanoSpice X™将 SPICE 级仿真能力从模块级延展至全芯片后仿真级别，破解超大规模电路仿真中的容量与内存瓶颈；NanoSpice Pro X™搭载双引擎架构，可智能识别电路拓扑并在 SPICE 与 FastSPICE 引擎间自动切换，同时进一步支持 3D-IC 和多工艺协同仿真需求；NanoSpice MS™实现 Verilog 行为级数字模型与晶体管级模拟电路的实时协同仿真，并与公司自研数字仿真器 VeriSim™无缝衔接。在此基础上，公司同步将电路仿真解决方案的能力边界从单一仿真环节延伸至设计早期静态电路检查、仿真阶段动态 SOA 分析、签核阶段良率评估与可靠性分析的全流程闭环，使各产品在统一框架下协同工作。此次升级通过智能调度、协同仿真与流程整合，将既有产品整合为有机协同的平台，实现从功能交付向系统性降低验证成本与周期的效能赋能的转型，为公司在 AI 大模型、自动驾驶等前沿芯片设计领域的市场拓展提供了坚实支撑。

(3) 测试仪器完整产品线构建

报告期内，公司正式推出 P1800 系列精密源测量单元，该产品依托公司长期积累的高精度 SMU、超低漏电矩阵、脉冲测试及低频噪声测试等核心技术，进一步完善了半导体电学测试产品矩阵。面对新材料、新工艺、新结构带来的更小物理尺度、更高功率密度、更复杂失效机制等研发挑战，公司已构建起涵盖电学参数测试、低频噪声测试、台式仪表、参数测试系统及专业测试软件在内的完整产品线，依托 FS 系列器件参数分析仪、981X 系列低频噪声分析仪等旗舰产品，能够为半导体工艺开发、器件表征、可靠性测试及模型提取等环节提供高效、高质量的数据支撑，从而优化工艺配方、改进器件性能、缩短研发迭代周期。这一布局标志着公司正从“软件工具”提供方向“数据获取与验证”环节纵深拓展，软硬件协同能力进一步增强。同时，公司强化半导体器件特性测试仪器业务与制造

类 EDA 工具及技术开发服务之间的交叉销售协同效应，持续打通从设计、测试到数据分析的闭环能力，为后续产品迭代与客户粘性提升奠定基础。

2. 坚持国际化战略，强化全球市场竞争力

2026 年上半年，公司境内市场业务收入实现稳步增长，2026 年 1-6 月来自境内的主营业务收入实现 19,243.26 万元，同比增长 16.22%，来自境内的收入占主营业务收入的比重达到 80.10%，同比增加 4.17 个百分点。公司始终坚持国际化战略，重视国际市场的开拓和发展，实现来自境外市场的主营业务收入为 4,779.82 万元，面对全球经济格局深度调整、外部环境复杂多变的形势，公司海外业务整体保持稳健运行，发展基础持续巩固。

2026 年上半年，公司向“一带一路”相关国家韩国、新加坡、马来西亚、奥地利等销售产品或提供服务，预计未来向“一带一路”相关国家和地区销售产品或提供服务会持续稳定输出；同时公司于报告期内完成了面向新加坡、韩国、俄罗斯等近 20 名外籍员工的第二类限制性股票归属登记工作，这一举措有效增强了外籍员工的归属感与凝聚力，为公司在“一带一路”相关国家开展业务储备了稳定的人才力量，也为企业在国际市场的长期发展奠定了坚实的人才基础，助力公司更好地融入当地市场，推动与沿线国家的合作向更深层次发展。

3. 推进募投项目建设和治理结构改善，增强可持续发展能力

（1）募投项目建设情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。对于本次结项形成的节余募集资金，公司于报告期内坚持审慎规划，对节余资金永久补充流动资金的部分统筹用于日常生产经营、技术创新、市场拓展及产业链协同等核心业务领域，进一步优化公司资金结构、提升资金使用效率，为公司实现长期可持续发展提供稳定的资金支撑，切实维护公司及全体股东的长远利益。

（2）治理架构完善情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门

委员会委员的议案》，同意提名张茹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并根据非独立董事补选结果，相应调整公司第二届董事会战略委员会委员；公司于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，选举张茹女士为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本报告期末，公司董事会由 9 名董事组成，全体董事均已到位，董事会严格按照法律法规及《公司章程》运作，为公司规范运作和稳健发展提供有力保障。

4. 坚持人才兴企战略，践行高质量发展理念

人才是驱动技术创新与业务发展的核心力量。报告期内，公司深入践行人才兴企战略，顺利完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属工作，合计归属限制性股票 1,400,982 股，覆盖高级管理人员及核心技术、业务骨干 100 余人，充分彰显了公司对核心人才的高度重视与正向激励导向。此次股权激励以股权为纽带强化利益共享机制，有效激发了员工的积极性与创造力，同时促进了人才队伍的稳定与优化。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员规模达 444 人，占员工总数的 73.63%，技术密集型组织定位进一步凸显，研发团队保持高学历、年轻化特征，其中硕士及以上学历人员占比 75.45%，40 岁及以下青年骨干占比 80.41%，为持续创新储备了充足的知识能力和活力优势。报告期内，公司重点引入 AI 算法、芯片设计、半导体工艺及 IP 等领域的高层次人才与技术专家，前瞻性优化核心人才结构，强化关键技术领域的战略布局；同时，公司持续完善内部培训体系，围绕技术研发、市场销售及项目管理等核心职能，系统开展多层次专业培训，全面提升员工专业技能与综合素质，并不断健全绩效考核与激励制度，有效调动员工积极性，为业务持续增长和技术长效创新提供有力的人力资源保障。

二、紧抓行业机遇，推动公司发展成为国内 EDA 平台型企业

1. 并购重组

公司持续推进实施通过发行股份及支付现金的方式取得成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称“锐成芯微”）100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称“纳能微”）45.64%股权事宜（以下简称“本次交易”），并于 2026 年 6 月取得中国证券监督管理委员会的注册批复。本次交易从受理至获批仅

用时约 6 个月，充分体现了监管层对硬科技企业实施并购重组的政策支持。通过整合锐成芯微与纳能微的优质半导体 IP 资源，依托二者已与全球 30 余家主流晶圆厂深度合作，累计沉淀的超千套成熟物理 IP 方案，公司可打通 EDA 软件与半导体 IP 的协同链路，成为国内首家具备“EDA+IP”双引擎动力的全链路赋能平台。本次交易系公司对标国际头部企业“EDA+IP 一体化”发展路径的关键战略布局，通过产品技术双向赋能与客户资源协同导流，持续加固产业生态壁垒，为集成电路产业核心技术突破与国产替代进程提供坚实支撑。

2. 产业投资

报告期内，公司持续深化产业投资基金的战略布局，以资本纽带推动 EDA 产业链上下游生态协同。2025 年 8 月，公司与上海芯合创联合发起设立临科芯伦，专注于 EDA 软件等行业及相关领域股权投资。在对外投资方面，临科芯伦先后出资受让鸿芯微纳 38.74%及 7.8125%股权，相关股权交割及工商变更登记均已办理完毕。目前，临科芯伦持有鸿芯微纳 46.5482%股权，成为第一大股东。鸿芯微纳作为国内数字后端 EDA 工具领域领先企业，在布局布线、时序优化等关键环节拥有成熟产品矩阵与技术积累。此前公司已与鸿芯微纳达成深度技术合作，本次投资则将技术协同升级为资本联动，进一步强化了股权纽带关系，为双方在数字后端领域的长期战略协同提供了有力保障，有效补齐了公司在数字芯片设计后端环节的能力拼图，提升了数字 EDA 领域的综合竞争力，体现了产业基金投资在赋能产业链中的核心纽带作用。

三、聚焦价值创造，打造概伦电子资本市场品牌美誉度

1. 信息披露提质高效

报告期内，公司积极响应交易所的制度修订要求，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件修订情况及规定，及时组织完成《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》等相关制度的修订工作，以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的修订说明。在响应时效与执行力度上均体现出合规主动性。

在信息披露内容的准确性与完整性方面，公司在 2026 年第一季度报告中，针对性地拓展了重大经营信息的披露维度。2026 年第一季度报告在保持核心数据连贯性的基础上，进一步补充了公司治理动态、股权管理动态和资本运作动态。通过持续且系统的信息披露方式，不仅让投资者能通过季度数据的纵向对比，精准追踪公司经营趋势，更通过信息维度的横向拓展，全面掌握业务发展的关键节点，有效保障了投资者获取信息的一致性与持续性，协助投资者作出价值判断和投资决策。

2. 股东结构持续优化

公司持续通过股东协议转让的方式优化股权结构，引入优质战略投资者，增强股权稳定性与战略协同效应。2026 年 1 月 12 日，公司股东 KLProTech、共青城明伦、共青城峰伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城毅伦、共青城智伦、井冈山兴伦（以上合称“转让方”）与上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）签署了《股份转让协议书》，转让方拟将其合计持有的公司 21,758,893 股概伦电子股份（占公司当时总股本的 5.00%）转让给上海科创集团，每股转让价格为 31.80 元，股份转让总价款为人民币 691,932,797.40 元。本次协议转让已于 2026 年 3 月 9 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次引入上海科创集团成为公司重要股东，一方面有助于优化公司股东结构，增强股权的长期稳定性与抗风险能力；另一方面，有望借助上海科创集团的区域产业生态与政策资源优势，在技术研发、产业链协同、人才引进及政策对接等方面形成战略合力，为公司后续发展注入持续动能。

3. 利润分配积极回馈

为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司制定并实施了 2025 年度权益分派实施方案：2025 年度，公司以总股本 436,578,835 股，扣除回购专用账户的股份 1,300,070 股后实际参与分配的股本总数为 435,278,765 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 13,058,362.95 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.13%，充分满足投资者的回报需求。自 2021 年底上市以来，公司持续落实利润分配制度，先后四次实施符合公司实际情况的现金分红方案。2021 年度共计派发现金红利 8,676,088.90 元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普

通股东净利润的比例为 30.33%；2022 年度共计派发现金红利 30,366,311.15 元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 67.65%；2024 年度共计派发现金红利 13,016,333.49 元（含税）。上市以来累计现金分红金额达 6,511.71 万元（含税）。

4.社会责任铸基育人

概伦电子长期致力于集成电路专业人才培养，深度投身教育部“101 计划”建设，携手产业链 22 家企业开展公益捐助，以实际行动助力“万套教材进课堂”落地实施。在具体实践中，公司从资金支持与专业共建两方面协同发力：一方面专项捐助资金用于首批“101 计划”核心教材在全国高校的推广与教学落地，为公益行动提供有力保障；另一方面公司副总裁马玉涛博士受邀参与《半导体器件物理》核心教材编撰，技术团队将前沿技术成果、真实研发场景及工程实践经验系统融入教材，有效弥补了传统教学与产业实操之间的衔接短板，提升了高校课程的实用性与前沿性。概伦电子通过资金与智力双轮驱动，将产业资源有效转化为教学资源，切实推动集成电路产教深度融合，为夯实我国集成电路产业人才底座贡献了企业力量。

5.投资者交流深化拓展

2026 年 4 月，公司围绕年度报告披露工作，精心策划并发布了“立山致远耀芯途”2025 年年度报告“一图读懂”长图可视化报告，以更加直观、通俗、高效的方式向资本市场传递公司价值。报告内容涵盖经营业绩、业务细分数据、研发创新、产品布局、人才发展、品牌建设、重点产业布局、投资进展、产学研合作及资本市场工作等多元维度，力求全面、客观、系统地呈现公司年度经营全貌与发展成效，精准回应投资者关注的核心议题。

在传播渠道方面，相关材料通过公司官方网站及官方微信公众号首发，并同步推送至东方财富企业号及同花顺企业号等主流财经资讯平台，有效扩大信息触达面，提升信息传递的时效性与覆盖面。此举旨在配合定期报告披露工作，持续丰富投资者沟通载体，优化信息传递体验，进一步增强报告的可读性、实用性与沟通效率。

公司始终重视与投资者的良性互动，致力于构建开放、透明、高效的投资者关系管理体系。未来，公司将继续探索多元化的沟通方式，不断提升信息披露质量与投资者服务水平，切实保障投资者的知情权与参与权，以更加务实的态度搭建起连接公司与资本市场的价值沟通桥梁。

以上内容是基于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案实施情况而作出的判断及评估。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，紧密结合自身经营实际与投资者关切重点，不断优化完善行动方案，稳步推进各项举措落地见效。本报告所涉及的公司发展规划、战略部署等内容，均属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者审慎判断，注意防范相关投资风险。

如有对本报告涉及相关内容或投资者关系事宜咨询，欢迎您按如下方式与公司取得联系：

投资者关系热线：+86-021-61640095

投资者关系邮箱：IR@primarius-tech.com

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日